

Leistungsstarke 3D-Sensorik für die Qualitätskontrolle von unten

Abschattungsfreie Ergebnisse durch Einsatz von acht geneigten Kameras

Flexibles Handling vieler sehr unterschiedlicher Prüfobjekttypen

Optionaler Rückföhrtransport der gefertigten Produkte

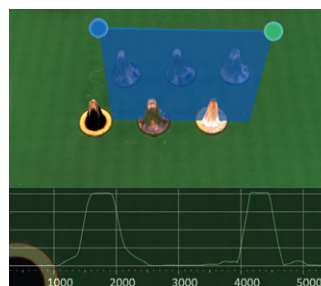
3D-Inspektion von Lötstellen auf Leiterplattenunterseiten

Mit diesem Maschinentyp bringt Viscom die eigene sehr große Kompetenz im THT-Bereich auf eine Linie mit seiner langjährigen Erfahrung aus der Entwicklung hochwertiger 3D-Inspektionssysteme für die SMD-Fertigung. Die S3016 *ultra* eignet sich bei Selektiv-Lötstellen, SMD-, Press-Fit- und THT-Bauteilen perfekt für die Inspektion von unten. Mit intelligenter und durchsatzstarker Inspektionstechnologie von Viscom können z. B. THT-Lötstellen exakt in 3D geprüft werden.

Die S3016 *ultra* ist einfach und effizient mit einem Verifikationsplatz von Viscom kombinierbar. Ergebnisse können komfortabel zusammen mit Daten und Bildern aus anderen Viscom-Prüföoren ausgewertet werden. Die Umsetzung einer effizienten statistischen Prozesskontrolle von Viscom ist ebenfalls möglich.

Auch bei hohen Taktzeitanforderungen sorgt die sehr leistungsstarke Sensortechnologie des Systems für höchste Prüftiefe. Beleuchtungen sind je nach Bedarf flexibel umschaltbar. Parallel zum Verfahren des Kameramoduls unterhalb der Leiterplatte mittels einer x-/y-Einheit zur nächsten Position werden bereits aufgenommene Bilder ausgewertet, was ein entscheidender Zeitvorteil ist.

Etablierte Prüfalgorithmen von Viscom ermöglichen neben der Pinvermessung u. a. auch eine schnelle Erkennung von offenen Lötstellen, Lotbrücken oder fehlenden Pins.



Zuverlässige 3D-Inspektion von THT-Lötstellen

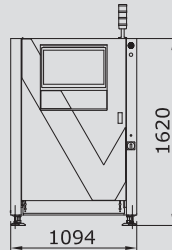


Fehlende Benetzung (vorne) und fehlender Pin (hinten)

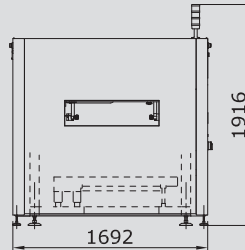
Technische Daten



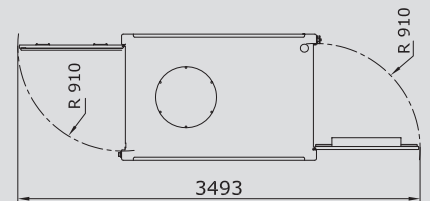
Vorderansicht



Seitenansicht inkl. optionalem Rückführtransport



Draufsicht



Angaben in mm

		S3016 ultra
Inspektionsumfang	3D-AOI	Selektiv- und Wellenlötung, Standardlötstellen nach IPC, Press-Fit
Sensorik	3D-Sensorik	
	Z-Auflösung	0,5 µm
	Z-Messbereich	Bis zu 30 mm
	Schrägsichtskameras	
	Anzahl der Megapixelkameras	8
Orthogonale Kamera		
	Auflösung	15 µm
	Bildfeldgröße	50 mm x 50 mm
Software	Bedienoberfläche	Viscom EasyPro/vVision-ready
	Statistische Prozesskontrolle	Viscom SPC/vSPC, offene Schnittstelle (optional)
	Verifikationsplatz	Viscom HARAN/vVerify
	Remote-Diagnose	Viscom SRC (Software Remote Control) (optional)
	Programmierplatz	Viscom PST34 (optional)
Systemrechner	Betriebssystem	Windows®
	Prozessor	Intel® Core™ i7
Leiterplattenhandling	Transportkonzept	Einspur-Transport, Rückführtransport (optional)
	Leiterplattengröße (L x B)	500 mm x 500 mm, Mindestbreite 70 mm
	Übergabehöhe	950 - 1000 mm ± 20 mm*; optionaler Rückführtransport: bis zu 300 mm
	Breitenverstellung	Automatisch
	Obere Durchfahrtshöhe (max.)	Bis zu 80 mm*
Untere Durchfahrtshöhe	Bis zu 50 mm	
Prüfgeschwindigkeit		Bis zu 65 cm ² /s
Sonstige Systemdaten	Verfahr-/Positioniereinheit	Synchron-Linearmotoren
	Schnittstellen	SMEMA
	Anschlusswerte	400 V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A, 4 - 6 bar Arbeitsdruck
	Systemmaße	1094 mm x 1565 mm x 1692 mm (B x H x T)
	Gewicht	750 kg

*Standardkonfiguration, weitere Höhen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten. Windows® und Intel® Core™ i7 sind eingetragene Warenzeichen.